**Effiziente Glasbearbeitung mit Laserstrahlen**

Minden – Auf der Glasstec 2022 in Düsseldorf stellt die cericom GmbH ihre Produktneuheiten vor und präsentiert damit wirtschaftliche Alternativen zur konventionellen Glasbearbeitung.

Das ostwestfälische Maschinenbauunternehmen cericom, Partner der LiSEC-Gruppe, produziert seit über 20 Jahren Laser-Spezialmaschinen zum Glasbohren, -schneiden, -fräsen, -entschichten, -kennzeichnen und -markieren. Auch die Arbeitsfelder Glasmattierung, Rutschhemmung und Innengravur gehören zum Leistungsspektrum. Auf der Glasstec zeigt das Unternehmen seinen Kunden und Interessenten, welche Vorteile die Lasertechnik bietet, insbesondere unter betriebswirtschaftlichen Aspekten.

**Mikrobearbeitung: Konturbohren und -fräsen**

Die Laserstrahl-Bearbeitung ermöglicht es, eine große Vielfalt von Formen und Mustern in Glas zu bohren, schneiden oder fräsen – mit cericom-Maschinen kann berührungslos und ohne Umweltbelastung durch Verbrauchsstoffe, Kühlmittel und deren Aufbereitung gefertigt werden.

**Makrobearbeitung: Entschichtung, Strukturierung und Glasinnengravur**

Darüber hinaus ermöglicht der Laserstrahl auch die Entschichtung oder Strukturierung von Glasoberflächen, zum Beispiel für Dekorationszwecke, zur Schaffung von Befestigungsstellen für Punkthalter oder zur Verbesserung der Durchlässigkeit für Mobilfunkstrahlung.

Normales oder eisenarmes Floatglas – auch als Bestandteil eines Verbundglases – kann einfach mit dem Laser innengraviert werden, zum Beispiel um Muster ins Glas einzubringen. Sogar Mehrscheiben-Verbundgläser mit Dicken über 50 mm können bearbeitet werden.

**Produktneuheit c-cut 300/300 | Laser-Glasbohr-/Fräsmaschine**

Ein Messe-Highlight ist die neue cericom c-cut 300/300, eine Maschine zum Laserschneiden, Bohren und Fräsen von optisch transparenten, spröden Materialien, die hauptsächlich für die Laserbearbeitung von Glas eingesetzt wird. Sie ermöglicht hochpräzises Schneiden und Bohren einem Bearbeitungsbereich von 100 mm x 100 mm entlang beliebiger 2D- oder 3D-Konturen, auf der Grundlage von Zeichnungen. Mit der neuen Maschine ist es nicht nur möglich, Werkstoffe mit Dicken von mehr als 20 mm zu schneiden, sondern auch Löcher hinunter bis zu Durchmessern von 200 μm zu bohren und Aspektverhältnisse (Lochdurchmesser : Bohrtiefe) von mehr als 1:25 zu erreichen. Die Bohr- und Schneid- und Fräsprozesse sind komplett „trocken“: Sie benötigen weder Wasser noch die zusätzlich erforderlichen Wasseraufbereitungsanlagen.

Vorteil: Eine äußerst schmale Schnittfugenbreite, kombiniert mit extremer Genauigkeit und hoher Auflösung ermöglicht Schnitte, die sich derzeit mit keinem konventionellen Glasbearbeitungsverfahren erzielen lassen. Das in der c-cut eingesetzte laserbasierte Verfahren ermöglicht erstmals eine effektive Art des Laserfräsens von Glas. So können Beispielsweise Senk- und Kegelbohrungen und andere nahezu beliebige 3D-Strukturen einfach und präzise in die Glasoberfläche gefräst werden.

**Produktneuheit c-mark | Lasermarkierungsmodul**

Ein weiteres Glasstec-Highlight ist das cericom-Markierungsmodul "c-mark": Es kommt überall zum Einsatz, wo es auf qualitativ hochwertige Markierungen ankommt oder wo Urheberrechte ein Thema sind: bei der Kennzeichnung von Sicherheitsglas, in der Autoindustrie und der Medizintechnik ebenso wie bei der Herstellung von Schmuck und Parfüms – als Stand-Alone-Lösung oder zur Integration in eine bestehende Anlage.

Mehr Infos: www.cericom.de

**Über cericom**

Seit 2002 entwickelt, produziert und vertreibt cericom (vormals cerion) weltweit Lasermaschinen für die Glasbearbeitung. Inzwischen bietet das Unternehmen ein breites Produktportfolio für die Laserbearbeitung von Glas an. Ob Kennzeichnung, Bohren, Schneiden, Mattieren, Innengravur, Entschichtung oder Strukturierung – zu all diesen Anwendungen existieren bei cericom geeignete Lösungen. Ob DIN-A4 oder 3 x 6 Meter Format, ob horizontal oder vertikal, ob als Insellösung oder Bestandteil einer Fertigungslinie – cericom bietet seinen Kunden eine passende Technologie maßgeschneidert für ihre Anwendung.

**Bildunterzeilen:**

Spiegelentschichtung mit dem Laserstrahl – auf einer cericom c-vertica.

Bild 69c00074

cericom c-cut 300/300: Das kompakte Design der Maschine ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Fertigungsanlagen.

Bild 69c90069

Lasermarkierer c-mark, hier als "Stand-Alone-Lösung"

Bild 69c00063

cericom auf der Glasstec 2022: Halle 17, Stand 17 B57.

Bild 69c90070

Zeichen (inkl. Leerzeichen): 4.048